

Title (en)

Method and apparatus for adjusting the gap between the rollers in a glue applicator for corrugated board

Title (de)

Verfahren und Vorrichtung zur Regelung der Höhe eines Walzenspaltes einer Beleimungs-Vorrichtung für eine Wellpappe-Bahn

Title (fr)

Dispositif de réglage de l'espacement de cylindres dans une machine d'encollage de papier ondulé

Publication

**EP 1199152 A2 20020424 (DE)**

Application

**EP 01122994 A 20010926**

Priority

DE 10052372 A 20001020

Abstract (en)

The frame (1) contains a glue-applicator roller (5) rotarily driven on a center lengthwise axle (8), and a pressure roller (10) rotarily driven on a center lengthwise axle (11). A corrugated cardboard web (47) consisting of at least one covering web (50) and corrugated web (49) travels through the gap (53) between the glue-applicator and pressure rollers. A dynamometer (34) measures the actual force in the gap at right angles to the web. The height of the gap can be altered by an adjustment (36), and a regulator (43) compares the actual and nominal forces in the gap.

Abstract (de)

In einer Beleimungs-Vorrichtung mit einer Leim-Auftrags-Walze (5) und einer Andrück-Walze (10) wird eine Wellpappe-Bahn (47) durch den zwischen den Walzen (5, 10) gebildeten Walzenspalt (53) geführt. Die Wellpappe-Bahn (47) wird im Walzenspalt (53) mit einer konstanten vorgegebenen Kraft gegen die Leim-Auftrags-Walze (5) angedrückt. <IMAGE>

IPC 1-7

**B31F 1/28**; **B05C 1/08**

IPC 8 full level

**B05C 1/08** (2006.01); **B05C 11/10** (2006.01); **B05D 1/28** (2006.01); **B05D 3/00** (2006.01); **B05D 3/12** (2006.01); **B05D 7/00** (2006.01); **B05D 7/24** (2006.01); **B31F 1/24** (2006.01); **B31F 1/28** (2006.01)

CPC (source: EP US)

**B05C 1/083** (2013.01 - EP US); **B31F 1/2818** (2013.01 - EP US)

Cited by

CN108973227A; CN106003830A; DE102012204878A1; CN111156232A; EP1763403A4; US8398802B2; US8057621B2; US11118314B2; US11162226B2; US11459704B2; US9649821B2; US10543654B2; US11260616B2; US7837927B2; US9981441B2; US10479043B2; US10882270B2; US11318701B2

Designated contracting state (EPC)

AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU MC NL PT SE TR

DOCDB simple family (publication)

**EP 1199152 A2 20020424**; **EP 1199152 A3 20040107**; DE 10052372 A1 20020502; JP 2002192637 A 20020710; US 2002046811 A1 20020425; US 6620455 B2 20030916

DOCDB simple family (application)

**EP 01122994 A 20010926**; DE 10052372 A 20001020; JP 2001316944 A 20011015; US 98279801 A 20011022